

证券代码：300054

证券简称：鼎龙股份

湖北鼎龙控股股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：20250507

投资者关系 活动类别	☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☒业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☐其他：
参与单位名称 及人员姓名	社会公众投资者
时间	2025 年 5 月 7 日下午 15:00-17:00
地点	微信小程序“投关易”
上市公司接待 人员姓名	公司董事长朱双全先生，董事、总经理朱顺全先生，董事、董事会秘书兼副总经理杨平彩女士，独立董事王雄元先生，董事、财务负责人姚红女士
投资者 关系活动 主要内容 介绍	业绩说明会就公司所处行业状况、发展战略、生产经营、财务状况及其他投资者关心的问题进行深入交流，主要交流内容如下： 问 1：2024 年公司营业收入同比增长 25.14%，归母净利润更是大幅增长 134.54%，请问净利润增长幅度远超营收增长，主要是哪些因素驱动的呢？ 答：感谢您的关注。2024 年度，公司实现营业收入 33.38 亿元，同比增长 25.14%；实现归属于上市公司股东的净利润 5.21 亿元，同比增长 134.54%。经营业绩同比变动的原因主要系：①半导体业务已成为驱动公司主营业务收入及净利润双增长的重要动力。公司 CMP 抛光材料、半导体显示材料产品已在国内主流晶圆厂、显示面板厂客户规模放量销售，市场渗透率持续提升，部分产品已取得国内龙头或销售领先的地位；报告期内半导体行业及新型 OLED 显示行业规模的增长，同样促进了公司半导体业务销售规模进一步提升。此外，公司前期孵化的半导体先进封装材料及高端晶圆光刻胶业务现均已取得销售收入，有利于上述新成长业务逐渐向减亏方向迈进。从而带动半导体业务及公司整体净利润规模的提升。②降本控费专项工作带来盈利能力和运营效率的提升。公司结合业务实际、寻找降本点并持续跟进，在成本优化，效率提升，重点运营费用控制等方面都取得了阶段性的成果，管理效能提升，盈利能力增强。 问 2：公司在半导体业务中，CMP 抛光垫、抛光液、清洗液以及半导体显示材料等细分领域增长迅速；请问公司在这些细分领域，是如何保持竞

争优势，进一步扩大市场份额的？

答：感谢您的关注。公司在半导体材料领域积累了较强的核心竞争能力，以增强相关产品的市场竞争优势，包括：（1）技术积累整合优势：鼎龙将二十多年来产品开发和成果转化的技术经验进行积累、整合，打造覆盖有机合成、高分子合成、无机非金属、物理化学等领域的七大技术平台，帮助公司在行业潜在竞争中更快更好地推出新产品。（2）自主应用评价验证优势：鼎龙坚持材料技术创新与用户验证工艺发展同步，自主搭建产品应用评价实验室，提升产品性能与客户需求的匹配度和在客户端验证的成功率，加深材料应用理解，更好地保障产品在客户端规模应用的稳定性。（3）供应链自主化优势：鼎龙坚持材料技术创新与上游原材料自主化培养同步，持续提升公司产品上游供应链的自主化程度，保障公司产品生产的自主可控、安全稳定，满足半导体行业客户对供应安全、品质稳定的核心诉求，并能在大规模量产阶段带来潜在的材料成本优势，也有助于从原料入手对产品进行定制开发。（4）知识产权布局优势：公司坚持材料技术的进步与知识产权建设同步，通过知识产权检索分析为新研发项目提供专利信息赋能；充分论证材料产品的自主知识产权，排除专利风险；研究布局核心产品专利，保护自身技术成果。此外，公司还具有产业链战略布局优势、研发生产基地前瞻性布局优势、半导体行业下游客户信任优势等，具体信息详见公司《2024 年年度报告》之“核心竞争力分析”。

问 3：请问今年公司在研发投入和技术创新上，有怎样的计划？

答：感谢您的关注。2024 年，公司研发投入金额 4.62 亿元，较上年同期增长 21.01%，占营业收入的比例为 13.86%。其中：已经放量的 CMP 抛光垫、半导体显示材料研发投入整体保持稳定，研发投入的增加主要系 CMP 抛光液、高端晶圆光刻胶业务对产品型号系统布局的要求较高，以及半导体先进封装材料、新领域芯片等新业务的投入。公司在半导体领域进行多元化的业务布局，虽然会在成长阶段因研发费用增加影响到归母净利润水平，但能在研发成果转化后推高公司未来业绩上限空间。2025 年，公司将持续关注相关产品研发进程，同时持续进行创新赋能，使用 AI 技术提升研发效率，努力保障在研产品的成果转化顺利进行。

问 4：朱总，公司研发投入持续增加，在研发团队建设方面，公司未来有哪些规划来吸引和留住高端技术人才，进一步提升公司的研发创新能力？

答：感谢您的关注。创新是企业发展的持续动力，公司结合整体业务发展战略持续进行人才团队培养和人员结构优化，不断增强公司技术人员与客户端实际应用工艺的沟通密度，持续进行创新材料与技术的平台化布局，进一步提升公司创新效率及创新成果转化率。同时，公司使用 AI 工具提升公司运行效率，探索 AI 技术在公司研发中的应用，如使用 AI 技术辅助进行材料配方和实验条件设计优化、分子合成路线设计、数据分析建模等过程，着力提升研发效率。此外，公司通过实施上市公司股权激励计划、子公司员工持股平台等，建立与员工利益共享、风险共担的长效激励约束机制，充分调动公司核心骨干员工的积极性，进一步保障核心人员稳定、积极、长期投入工作。

问 5：朱董，展望 25 年半导体板块营收占比能达到多少

答：感谢您的关注。2024 年，公司半导体板块业务（含半导体材料业务及集成电路芯片设计和应用业务）实现主营业务收入 15.2 亿元（其中芯片业务收入已剔除内部抵消），同比增长 77.40%，占公司总营业收入比例持续提升。目前，公司 CMP 抛光材料、半导体显示材料产品已在国内主流晶圆厂、显示面板厂客户规模放量销售，市场渗透率持续提升，半导体先进封装材料及高端晶圆光刻胶业务现均已取得销售收入。2025 年，公司也将重点推进半导体相关材料业务的持续放量，努力提升半导体板块营收占比。

问 6：你好，请问对于半导体材料应用市场未来发展有什么看法？谢谢！

答：感谢您的关注。半导体产业是引领新一轮科技革命和产业变革的关键力量，已成为驱动新质生产力的关键引擎，其技术创新正加速各行业智能化转型。生成式人工智能需求、汽车行业增长、物联网设备扩展和 5G/6G 技术部署等，预计将是 2025 年半导体行业增长的关键促进因素。显示产业在电子信息产业中占据重要地位，是国家战略性支柱产业，其中 OLED 是现阶段显示产业发展的重点领域。从终端应用来看，智能手机是当前 OLED 领域最大的应用市场，占比超过 70%，且 2024 年增长势头强劲；此外，中大尺寸 OLED 技术快速发展，应用渗透率未来可能持续提升。相关行业发展情况详见公司《2024 年年度报告》之“报告期内公司所处行业情况”。下游终端需求的扩张及工艺技术的进步，能推动产业上游相关材料市场的持续增长。此外，近期的关税政策等国际贸易形势变动，可能触发进口多元化和国产替代效应，从而推动国内泛半导体产业自主化程度进一步提升。但同时，下游客户对于国产材料供应商的产品型号覆盖率、原材料自主化率有了更严格的要求。公司作为半导体材料的国产供应商，业务布局覆盖 CMP 抛光材料、半导体显示材料、高端晶圆光刻胶、半导体先进封装材料，对标的进口替代产品线广，且上游核心原材料实现了自主可控，这有利于公司在新的贸易形势下加速开拓客户、提升市场份额，努力提高公司全年业绩。

问 7：公司作为泛半导体材料的国产供应商，且上游核心原材料实现了自主可控。在当前复杂的贸易形势下，这一优势对公司开拓国内外市场起到了积极作用；请问公司在利用这一优势进一步拓展国际市场方面，有哪些具体的市场策略和计划？

答：感谢您的关注。近期的关税政策等国际贸易形势变动，可能触发进口多元化和国产替代效应，从而推动国内泛半导体产业自主化程度进一步提升。但同时，下游客户对于国产材料供应商的产品型号覆盖率、原材料自主化率有了更严格的要求。公司作为半导体材料的国产供应商，业务布局覆盖 CMP 抛光材料、半导体显示材料、高端晶圆光刻胶、半导体先进封装材料，对标的进口替代产品线广，且上游核心原材料实现了自主可控，这有利于公司在新的贸易形势下加速开拓客户。公司将在新的竞争态势中适时调整竞争策略，积极推广市场，努力推高全年销售进一步增长。

问 8：公司在高端晶圆光刻胶业务领域，浸没式 ArF 及 KrF 晶圆光刻胶产品首获国内主流晶圆厂客户订单；在半导体先进封装材料业务领域，首次获得半导体封装 PI、临时键合胶产品的采购订单；对于这些新业务的

突破，公司后续将如何加快产品的产业化进程，提高产品的市场认可度和销售规模？

答：感谢您的关注！近年来，公司持续在技术壁垒高、国产替代需求迫切的半导体材料领域持续加大投入。为加快晶圆光刻胶、先进封装材料等新业务产业化进程，在技术研发方面，公司将不断优化配方与工艺，提高产品性能；在产能建设方面，推进潜江二期年产 300 吨 KrF/ArF 高端晶圆光刻胶量产线建设，有序提升半导体封装 PI、临时键合胶等产品的产能利用率；同时积极拓展客户，不断提升上述产品的市场认可度和销售规模。

问 9：你好，请问公司已生产的光刻胶产品质量是否已达到国际同类产品水准？谢谢！

答：感谢您的关注和提问！公司在光刻胶领域投入大量研发资源，目前已布局 20 余款高端晶圆光刻胶，已有 12 款送样客户端验证，其中 7 款进入加仑样阶段。公司某款浸没式 ArF 及 KrF 晶圆光刻胶已通过客户验证并首获国内主流晶圆厂客户订单。同时，公司开发出 KrF、ArF 光刻胶专用树脂及其高纯度单体、光致产酸剂等关键材料，实现从关键材料到光刻胶产品自主可控的全流程国产化，符合下游客户产业链供应链安全自主可控的需求。

问 10：你好，请问公司募投项目建设进度如何？谢谢！

答：感谢您的关注。公司本次可转债募投项目中，潜江二期年产 300 吨 KrF/ArF 高端晶圆光刻胶量产线建设在按计划顺利推进中，主体设备基本到位，进入设备安装阶段。光电半导体材料上游关键原材料国产化产业基地项目也在按预期进展推进。后续具体进展信息请以公司公开披露的公告为准。

问 11：请问公司未来对打印复印通用耗材业务有怎样的发展定位和规划？如何通过技术创新和市场拓展，提升该业务的盈利能力和市场竞争力？

答：感谢您的关注。公司是打印复印通用耗材龙头企业，以全产业链运营为发展思路，上游提供彩色聚合碳粉、显影辊等打印复印耗材核心原材料，下游销售硒鼓、墨盒两大终端耗材产品，实现产业上下游的联动，支持公司的竞争优势地位。在打印复印通用耗材业务板块，公司在成本挖潜、提升运营效率方面持续发力，抓实各项降本增效工作，结合各细分业务特点进行产品降本、物料降本、运费管控、人效提升等多项优化，包括：专项优化采购供方选择和比价，多渠道供应资源优化管理；优化客户及产品结构，持续产品降本方案，降低模具及生产辅助耗材成本，提高产品合格率；集中排产、出货管理，整合空运点加大海运，优化库存及物流成本管理；优化人工配置、充分发挥自动化生产效率，提升人均产出及效率等。通过多举措提升整体盈利能力，综合竞争力持续增强。

问 12：你好，请问关税增加是否会对公司通用耗材业务产生影响？谢谢！

答：感谢您的提问。在打印复印通用耗材业务板块，上游彩色碳粉、芯片产品盈利能力较强，以内销为主；耗材板块中出口产品主要为终端的硒鼓、墨盒产品，上述两大类产品的出口区域广泛分布在欧洲、亚太、南美、北美等地区，不存在依赖美国市场的情形。市场及客户结构具备较强的抗风险能

	力。因此，目前来看，关税政策调整尚未对公司耗材业务产生重大影响。 问 13: 公司拟定 2024 年度利润分配方案为每股派发现金红利 0.21 元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为 30.26%，请问公司制定这样的利润分配方案，主要基于哪些考虑因素？ 答：感谢您的关注。公司 2024 年度分红方案是每 10 股派发现金红利 1.00 元。现暂以截至 2024 年 12 月 31 日的总股本 938,282,591 股为基数测算，预计派发现金股利 93,828,259.10 元。同时，公司在 2024 年度采用集中竞价方式实施的股份回购金额为 150,009,045 元。综上，公司现金分红和股份回购总额合计为 243,837,304.10 元，占 2024 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的 46.83%。上述分红方案是公司董事会综合考虑盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素提出，符合相关法律法规的要求。 问 14: 请问应收账款的回收情况如何？在应收账款管理方面，公司采取了哪些措施来降低坏账风险，确保公司资金的正常周转和财务状况的稳定？ 答：感谢您的关注！目前公司应收账款整体回款情况良好，风险可控。为降低坏账风险，公司一方面会严格监控应收账款账期，紧密跟踪客户经营财务状况，对可能逾期风险的账款提前预警并采取措施；另一方面，境外客户的应收账款办理中国出口信用保险，境内客户则采取资产抵押、必要时司法介入等方式加大回款力度，保障公司资金正常周转和财务稳定。 问 15: 随着行业的快速发展和技术的不断进步，公司在未来是否有计划拓展新的业务领域，以实现多元化发展？ 答：感谢您的关注。鼎龙股份是国内领先的关键大赛道领域中各类核心“卡脖子”进口替代类创新材料的平台型公司，目前重点聚焦半导体创新材料领域中：半导体制造用 CMP 工艺材料和晶圆光刻胶、半导体显示材料、半导体先进封装材料三个细分板块，并持续在其他相关大应用领域的创新材料端进行拓展布局。未来公司如有拓展新的业务领域，请以公司公开披露的公告为准。
附件清单	无
日期	2025 年 5 月 7 日